

MEDIENINFORMATION

ASM Schablonendrucker DEK TQ Next Generation

Kompakte Höchstleistung für die flexible SMT-Automatisierung

München, 23. November 2021 – mit dem Schablonendrucker DEK TQ der nächsten Generation präsentiert ASM die ideale Verbindung von High-End-Qualität und flexibler Automatisierung. Mit einer Nassdruckgenauigkeit von $\pm 17,5 \mu\text{m}$ @ 2 Cpk bei minimaler Kernzykluszeit von bis zu 5 Sekunden setzt der DEK TQ Bestmarken in punkto Leistung, Effizienz und Präzision. Neue Features wie Smart Pin Placement oder DEK All Purpose Clamping ermöglichen die individuelle Graduierung der Automatisierung. Zudem ist der neue DEK TQ für bedienerlose Laufzeiten bis zu acht Stunden und mehr konzipiert. Über offene Schnittstellen ist eine einfache und schnelle Einbindung in die Integrated Smart Factory gewährleistet.

DEK TQ ist der bevorzugte Lotpastendrucker, wenn es um Automatisierungskonzepte in der SMT-Fertigung geht. Dabei kann der Grad der Automatisierung je nach Anforderung individuell gestaltet werden. Zur Minimierung manueller Eingriffe in den Druckprozess verfügt der DEK TQ optional über ein automatisches Pastenmanagement mit Pastenauftrag und integrierter Pastenhöhenkontrolle. Darüber hinaus bietet das optionale Dual Access Cover die Möglichkeit, Lotpastenkartuschen durch einen gesonderten Zugang im laufenden Betrieb zu wechseln. Die ROI-Berechnung ergibt eine Amortisierung des vollautomatischen Pastenmanagements inklusive Dual Access Cover im Vergleich zur manuellen Bedienung bereits nach wenigen Monaten.

Bis zu mehr als acht Stunden Dauerbetrieb

In Verbindung mit dem hocheffizienten Unterseitenreinigungssystem inklusive extragroßer Vliesrolle und dem sieben Liter fassenden Tank für Reinigungsflüssigkeit arbeitet der Drucker je nach Reinigungsanforderung mindestens acht Stunden ohne

Bedienereingriffe. Denn wie die Lotpaste, so kann auch die Reinigungsflüssigkeit unterbrechungsfrei nachgefüllt werden, da sich der Tank in einen Fünf-Liter-Haupttank und einen Zwei-Liter-Puffertank aufteilt.

NEU: Smart Pin Placement

Mit dem optionalen Feature Smart Pin Placement verfügt der Elektronikfertiger über eine weitere Möglichkeit, manuelle Eingriffe zu reduzieren. Zwei automatische platzierbare Pin-Größen (Durchmesser 4 mm und 12 mm) können vollautomatisch gesetzt werden. Nach dem Setzen der Pins wird automatisch die Position und einzigartig in der Industrie auch die Pinhöhe verifiziert.

Offene Schnittstellen wie IPC-Hermes-9852, Closed-Loop-to-SPI, ASM OIB oder IPC-CFX erlauben eine einfache und schnelle Eingliederung in die Smart Integrated Factory und geben zusätzliche Investitionssicherheit.

DEK TQ: Bestmarken für die Volumenfertigung

DEK TQ setzt Bestmarken bei Leistung, Effizienz und Präzision. Auf einer Stellfläche von nur 1,3 × 1,0 m erreicht der Volumendrucker eine Kernzykluszeit von nur fünf Sekunden und ermöglicht so höchste Durchsätze. Durch den Einsatz von präzisen Linearantrieben, Offbelt-Printing, innovativen Klemmsystemen und eines weiterentwickelten Druckkopfes kommt der DEK TQ dabei auf eine Nassdruckgenauigkeit von $\pm 17,5 \mu\text{m}$ @ 2 Cpk. Dies ermöglicht den zuverlässigen Druck von 0201 (metrisch) Bauelementen sowie für moderne Ultra-Fine-Pitch-Anwendungen. Zwei DEK TQ können darüber hinaus auch „Back-to-Back“ an SMT-Linien mit Doppeltransport betrieben werden – dies verdoppelt die Kapazität des Lotpastendrucks auf einen Schlag.

DEK All Purpose Clamping – Drucken bis ganz nah an den Rand



DEK All Purpose Clamping (APC) ist ein universelles und das mit Abstand flexibelste Klemmsystem von ASM: Die Klemmung kann wahlweise von oben, von der Seite oder im „Foiless Mode“ erfolgen – ganz so, wie es die Anwendung erfordert. Auch verzogene Leiterplatten werden über die flexiblen Klemmen sicher fixiert. Die oberen Klemmmesser sind dazu noch flexibel gelagert, wodurch sich

die Oberklemmung bei Bedarf ganz auf die Höhe der Leiterplattenoberkante zurückziehen kann. Der Vorteil: So können auch die Randbereiche der Leiterplatte zuverlässig und in höchster Qualität bedruckt werden. DEK APC passt sich automatisch und sicher der Form und Stärke der Leiterplatte an: unterschiedliche Stärken, Boards mit nicht parallel laufenden Kanten – alles kein Problem. Möglich wird dies alles durch software-kontrollierte Linearantriebe, die dem Anwender die volle Kontrolle überlassen. Die Klemmung wird job-spezifisch in der Software konfiguriert und Sensoren überwachen die vorher programmierte Klemmkraft. Die im Produktsetup vorgenommenen Einstellungen können dazu auch für künftige Produktionen gespeichert werden. Der Gewinn: deutliche Zeitersparnis, mehr Möglichkeiten im Lotpastendruck sowie eine verbesserte Stabilität des Druckprozesses.

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:

<http://www.htcm.de/kk/asm>

 <p>Bildquelle: ASM</p> <p>Der Schablonendrucker DEK TQ arbeitet mindestens 8 Stunden ohne Bedieneringriffe – ideal für den Einsatz in Automatisierungskonzepten.</p>	 <p>Bildquelle: ASM</p> <p>DEK All Purpose Clamping, ASM's flexibelstes Klemmsystem, erweitert die Möglichkeiten von DEK TQ noch einmal erheblich.</p>
---	---



Bildquelle: ASM

Die patentierte ASM Lösung DEK Alignment sorgt für höchste Präzision im Lotpastendruck.



Bildquelle: ASM

Das optionale Dual Access Cover ermöglicht den Austausch von Lotpastenkartuschen im laufenden Betrieb.

Das Geschäftssegment SMT Solutions der ASM Pacific Technology

Der Auftrag des Geschäftssegments SMT Solutions im Konzern ASM Pacific Technology (ASMPT) ist der Support, die Implementierung und die Realisierung der SMT Smart Factory bei Elektronikfertigern weltweit.

ASM Lösungen wie die SIPLACE Placement Systems und die DEK Printing Solutions unterstützen auf Linien- und Fabrikebene mit Hardware, Software und Services die Vernetzung, Optimierung und Automatisierung von zentralen Workflows und erlauben Elektronikfertigern somit den schrittweisen Übergang zur Smart SMT Factory mit dramatischen Verbesserungen bei Kennzahlen/KPIs für Produktivität, Flexibilität und Qualität.

Zentrales Strategieelement bei ASM ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. So initiierte ASM das SMT Smart Network als globales Kompetenznetzwerk für den aktiven Erfahrungsaustausch von Smart Champions.

Mehr Informationen zu ASM finden Sie auf www.asm-smt.com.

Über ASM Pacific Technology Limited

ASMPT (HKEX stock code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur bietet als globaler Technologie- und Marktführer führende Lösungen und Materialien für die Halbleiter-Montage- und Verpackungsindustrie. Die SMT-Lösungen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Industrie und LED. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen dazu bei, seinen Kunden innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anzubieten, mit denen sie eine höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erreichen können.

Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf www.asmpacific.com.

Pressekontakte:

Global ASM Press Office
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Susanne Oswald
Rupert-Mayer-Straße 44
81379 München
Deutschland
Tel: +49 89 20800-26439
E-Mail: susanne.oswald@asmpt.com
Website: www.asm-smt.com

HighTech communications GmbH
Barbara Ostermeier
Brunhamstraße 21
81249 München
Deutschland
Tel.: +49-89 500778-10
Fax: +49-89 500778-78
E-Mail: b.ostermeier@htcm.de
Website: www.htcm.de